Cambios a la BOM. v6-v8.

* La posición 5 cambia su cantidad de 2 a 1.
* La posición 11 cambia su valor de 10mR a 100mR.
* La posición 17 cambia su cantidad de 3 a 2.
* La posición 19 aumenta su cantidad de 4 a 6.
* La posición 25 cambia su cantidad de 3 a 0.
* La posición 31 cambia su cantidad de 4 a 2.
* La posición 33 cambia su cantidad de 1 a 2.
* Se añade la posición 67: Memoria EEPROM(AT24MAC602-STUM-T) SOT23-5, cantidad 2.
* Se añade la posición 68: Resistencia SMD-0402 de 150k, cantidad 2.
* Se añade la posición 69: Resistencia SMD-0402 de 47k, cantidad 1. (Revisar el valor pq podria ponerse algún otro que ya existiera)
* Pos 28 pasa de cantidad 1 a 2 unidades

|  |  |
| --- | --- |
| CPU | Se crea una nueva posición 24 con los valores de R17 una resistencia 0402 de 150k cantidad de 1. |
| CPU | La posición 10 añade una nueva Part R14 y aumenta su cantidad de 1 a 2. |
| DCDC | De la posición 18 se borra el part R40 Y R43 disminuyendo su cantidad a 3 (de 4 a 2) |
| DCDC | Se crea la posición 33 con el part R43 de valor de 47k, Package 0402 y con cantidad 1. |
| DCDC | De la posición 14 se borran R13 y R14 disminuyendo su cantidad de 3 a 1. |
| DCDC | La posición 12 se añade el part R14 y se aumenta su cantidad a 2. |
| DCDC | Se crea la posición 34 con el part R15 de valor 150k y package 0402. |
| DCDC | De la posición 2 se borra el part C20 y se disminuye la cantidad de 2 a 1. |
| DCDC | De la posición 18 se borra el part R40 y se disminuye la cantidad de 3 a 2. |
| DCDC | Se crean las posiciones 35 y 36 para indicar que los part C20 y R40 no se tienen que montar. |
| DCDC | En la posición 26 se cambia el valor de 10mR a 100mR. |
| DCDC | En la posición 14 se cambia el valor de 15k a 2k7. |
| DCDC | En la posición 15 se cambia el valor de 1k a 4k7 |
| INPUT | Se añade R2 (pos 4) |